

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム (SenTePack)
第2回総会・第4回研究会 プログラム

- 1、開催日時：2026年2月20日(金) 13:00~16:55
- 2、開催方式：会場/Online (ハイブリッド開催)
- 3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11階 第1会議室
- 4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
- 5、プログラム：

13:00~13:30 総会

13:30~13:40 研究会開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖

13:40~14:20 WG 活動報告

- ・センシング材料 WG
- ・環境モニタリング技術 WG
- ・人・機械インタラクション WG
- ・半導体製造センシング・実装技術 WG

14:20~15:20

講演1「製造DXの現在地と次の一手」

株式会社 SparkPlus CEO 本田 純平 様

- ・概要：AI導入をPoCで終わらせず現場定着へ導く「製造DXの現在地と次の一手」を解説。半導体・センサ製造の現場課題に対し、最新のAIエージェント技術等をどう活用すべきか。成功・失敗事例を交え、実運用を見据えたAI実装の要諦をSpark+代表の本田が解説します。

15:20~15:50 コーヒーブレイク (名刺交換・意見交換)

15:50~16:50

講演2「次世代半導体を支える3D集積・チップレット技術の研究開発動向と産業展開」

横浜国立大学 准教授 井上 史大 様

- ・概要：本講演では、AI半導体の高性能化・高集積化要求を背景に重要性が高まる3D集積・チップレット技術について、研究開発動向と産業展開を俯瞰する。微細化限界を超える実装技術としての役割、接合・配線・熱設計などの技術課題、ならびに量産化・エコシステム形成の現状と今後の方向性を概説する。

16:50~16:55 研究会閉会挨拶 SenTePack 副会長 吉田 学

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp